



kingston.com/epop

ePoP

ePoP - 可穿戴裝置的嵌入式層疊封裝記憶體

Kingston 的 ePoP 提供高度整合的 JEDEC 標準元件，將嵌入式多媒體卡 (eMMC) 儲存裝置以及低功耗雙倍資料速率 (Low-Power Double Data Rate, LPDDR) DRAM 與嵌入式層疊封裝 (Package-on-Package, PoP) 解決方案結合。ePoP 直接安裝在相容主機的系统單晶片 (SoC) 頂端，可減少 PCB 板空間，並且確保最佳效能。ePoP 是用於空間受限的應用 (例如可穿戴裝置) 的理想解決方案。

主要優點

- 藉由直接安裝在主機 SoC 頂端，ePoP 為小型尺寸應用 (例如可穿戴裝置) 提供了理想的解決方案。
- 低功耗 DRAM 和最佳化的儲存裝置韌體可降低功耗，同時提供電池供電的可穿戴裝置應用所需的高性能。
- 簡化系統設計，加快上市時間，並且縮短鑑定週期。
- 多種韌體配置，在性能、功率和使用壽命方面提供最適合您的解決方案。

市場區隔



物聯網 (IoT)



可穿戴裝置



擴增實境 (AR) / 虛擬實境 (VR) 裝置

EPOP 產品型號及規格

LPDDR3-based ePoP

產品型號	儲存容量		標準		包裝	FBGA	作業溫度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	10x10x0.8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5.0	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5.1	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5.1	LPDDR3	10x10x0.85	136	-25°C ~ +85°C

LPDDR4x based ePoP

產品型號	儲存容量		標準		包裝	FBGA	作業溫度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.85	144	-25°C ~ +85°C

*pSLC 模式可提供較高的耐用性